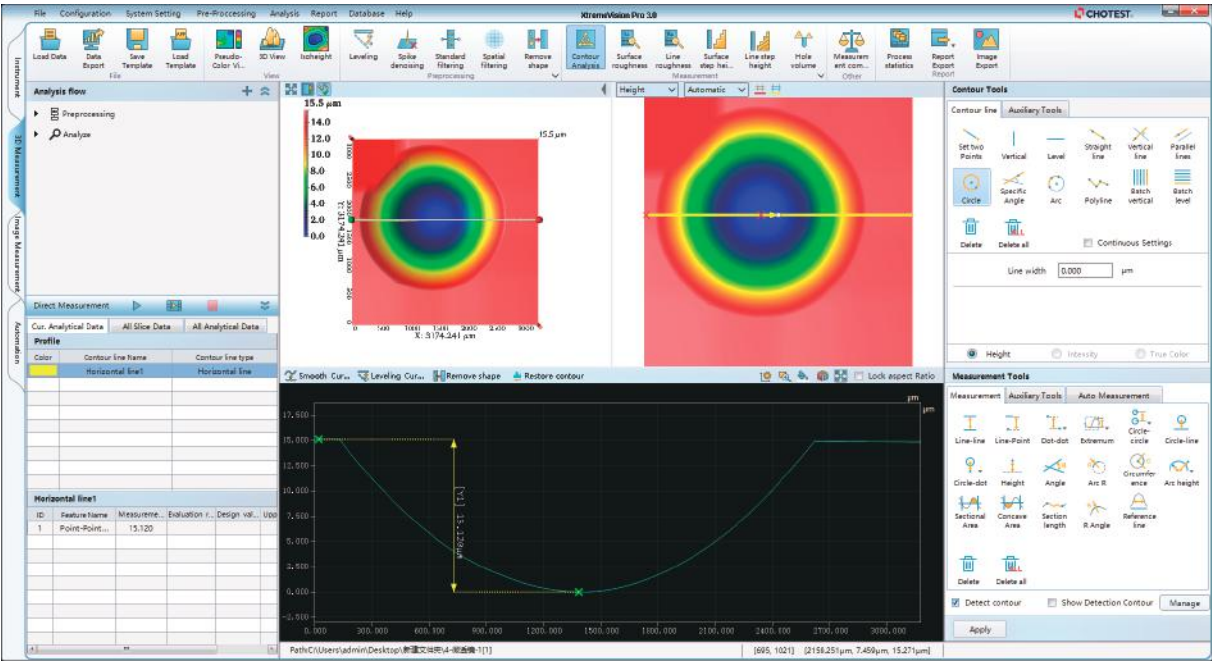


Logiciel XtremeVision 3D



Le logiciel de mesure microscopique 3D de seconde génération, développé en interne, intègre quatre fonctions modulaires : acquisition d'images, analyse 3D, mesure d'images et mesure automatisée. Il s'adapte parfaitement à tous les modèles de machines microscopiques 3D des séries CHOTEST W, VT et WT, et est capable d'identifier automatiquement le type de modèle. Le logiciel peut également basculer automatiquement entre les modes de scan par interférométrie en lumière blanche et par microscopie confocale sur les profilomètres optiques 3D hybrides 2-en-1.

Spécification de lentille

Rapport de zoom de l'objectif			2.5x	5x	10x	20x	50x	100x
Diamètre d'ouverture numérique / résolution optique à 550 nm (µm)			0.075	0.13	0.3	0.4	0.55	0.7
			3.7	2.1	0.92	0.69	0.5	0.4
Profondeur de mise au point (µm)			48.6	16.2	3.04	1.71	0.9	0.56
Distance de travail (mm)			10.3	9.3	7.4	4.7	3.4	2.0
F.O.V. H×V (mm)	Système vidéo 1024 x 1024	0.5x	3.84x3.84	1.92x1.92	0.96x0.96	0.48x0.48	0.192x0.192	0.096x0.096
		0.75x	2.56x2.56	1.28x1.28	0.64x0.64	0.32x0.32	0.128x0.128	0.064x0.064
		1x	1.92x1.92	0.96x0.96	0.48x0.48	0.24x0.24	0.096x0.096	0.048x0.048

Parameters

Référence		SuperView W1	SuperView W1-Pro	SuperView W1-Ultra	SuperView W1-Lite
Source lumineuse		LED Blanche			
Système vidéo		1024×1024			
Objectif		Standard : 10× (option : 2.5×, 5×, 20×, 50×, 100×)			
Zoom optique		Standard: 0.5X Option: 0.375X, 0.75X, 1X			Standard: 0.5X Option: 0.375X, 0.75X
Champ de vision standard		0.98×0.98 mm		1.1×1.1 mm	0.98×0.98 mm
Tourelle d'objectifs		Tourelle manuelle 3 emplacements (option : motorisée 5 positions)			Tourelle motorisées 5 positions
XY Object Table	Dimensions	320×200mm	300×300mm	320×200mm	220×220mm
	Course de déplacement	140×100mm	200×200mm	140×100mm	100×100mm
	Capacité de charge	10kg			
	Méthode de contrôle	Motorisé			
Inclinaison (manuelle)		±4°			±3°
Axe Z	Course de déplacement	100mm			50mm
	Méthode de contrôle	Motorisé			
Plage de balayage en Z		10mm			
Répétabilité de la forme de surface*1		0.1 nm			
Répétabilité de la rugosité RMS*2		0.005nm			0.01nm
Mesure de hauteur de marche*3		Précision: 0.3%; Répétabilité: 0.08%(1σ)			Précision: 0.7% Répétabilité: 0.1%(1σ)
Vitesse de balayage à résolution 0,1 nm		1.85µm/s	1.85µm/s	8µm/s	1.65µm/s
Poids		140 kg	170 kg	140 kg	50 kg
Dimensions (LxIxH) mm		700×600×920	750×650×950	700×600×900	500×400×700
Environnement d'exploitation	Température	0°C~30°C, fluctuation <2°C/60min			
	Humidité	5 % à 95 % HR, sans condensation			
	Vibration	VC-C ou supérieur			
	Evaluation du bruit logiciel*4	3σ≤4n m			
	Air comprimé	0,6 MPa, sans huile ni eau, diamètre de tuyau 6 mm			
	Alimentation électrique	AC100~240V, 50/60Hz, 4A, 200W			
	Autres	Pas de champ magnétique intense, pas de gaz corrosif			

Note:
*1 Utiliser le mode EPSL pour mesurer un wafer silicium Sa 0,2 nm en environnement de laboratoire ; une seule bande, filtre 80 µm pour champ de vision complet.
*2 Mesure d'un wafer silicium Sa 0,2 nm en environnement de laboratoire conformément à la norme ISO 25178.

*3 Mesure d'un bloc étalon de hauteur de marche 5 µm en environnement de laboratoire conformément à la norme ISO 1060-1:2009.

*4 Lorsque l'évaluation du bruit logiciel est comprise entre 4 nm ≤ 3σ ≤ 10 nm, la répétabilité de la rugosité RMS est révisée à 0,015 nm, la précision de mesure de la hauteur de marche à 0,7 %, et la répétabilité de la mesure de hauteur de marche à 0,12 % ; lorsque l'évaluation du bruit logiciel est 3σ > 10 nm, l'environnement ne répond pas aux exigences d'utilisation de l'équipement et le site doit être modifié.